

平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年7月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 佐伯 幸雄

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第1四半期	68,915	△55.5	△14,388	—	△14,021	—	△11,035	—
21年3月期第1四半期	154,827	—	21,430	—	22,263	—	12,853	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第1四半期	△61.66	—
21年3月期第1四半期	71.83	71.69

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第1四半期	640,369	520,326	79.5	2,846.00
21年3月期	668,998	529,265	77.5	2,896.55

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 509,353百万円 21年3月期 518,387百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	20.00	—	4.00	24.00
22年3月期	—	—	—	—	—
22年3月期(予想)	—	4.00	—	4.00	8.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期連結累計期間	144,000	△52.2	△36,000	—	△35,000	—	△26,000	—	△145.27
通期	318,000	△37.4	△57,000	—	△55,000	—	△38,000	—	△212.32

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注) 詳細は、6ページ「定性的情報・財務諸表等 4. その他」をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第1四半期	180,610,911株	21年3月期	180,610,911株
② 期末自己株式数	22年3月期第1四半期	1,639,333株	21年3月期	1,643,398株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第1四半期	178,969,913株	21年3月期第1四半期	178,932,452株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 平成21年5月14日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。
- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、5ページ「定性的情報・財務諸表等 3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済を地域別にみますと、アジア経済は中国をはじめ景気回復の動きがみられましたが、欧米では金融危機と実体経済悪化により引き続き深刻な状況にありました。また、日本経済は輸出が増加に転じ、生産は底入れ感が出始め最悪期を脱しつつあるものの、企業収益が改善する見通しが立っていないなかで設備投資は抑制されるなど厳しい状況が続きました。

当グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、パソコンや携帯電話、デジタル家電等の電子機器の需要は引き続き低迷しており、半導体・FPD関連市場は、在庫調整が一巡したことによる半導体価格の回復、中国向けの液晶パネル需要の増加など、底入れの兆しが見え始めましたが、まだ本格回復には至らず厳しい状況が続きました。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高689億1千5百万円(前年同期比55.5%減)、営業損失143億8千8百万円(前年同期比358億1千8百万円減)、経常損失140億2千1百万円(前年同期比362億8千4百万円減)、また、拠点効率化に伴う減損損失を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は110億3千5百万円(前年同期比238億8千8百万円減)となりました。

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりです。

(1) 産業用電子機器事業

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、504億7千万円(前年同期比61.1%減)となりました。

① 半導体製造装置

世界的な半導体不況により、半導体メーカーは設備投資の抑制を継続しており、当部門の売上は低調に推移しました。また、足元では在庫調整の進展による半導体価格の回復、半導体メーカーの設備稼働率の上昇など底入れの兆しが見えており、当部門の受注高も3四半期ぶりに増加に転じましたが、本格的な回復には至らず厳しい状況が続いております。このような状況のもと、当部門の当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、304億3千7百万円(前年同期比73.0%減)となりました。

② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽電池) 製造装置

昨年からの最終製品需要の低迷により、パネルメーカーによる設備投資抑制・延期の影響を受けましたが、当部門の当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、199億4千3百万円(前年同期比15.5%増)と前年同期比で増加しました。また、中国向けの液晶パネル需要の増加により、一部パネルメーカーにおいて増産や設備投資再開の動きが見られるなど、事業環境は好転し始めております。また、太陽電池製造装置分野につきましては、環境対策の世界的な広がりを背景に、当社のビジネスも引き合いは旺盛であります。昨年からの世界金融危機の影響により、投資時期が延期される傾向となっております。

③ その他

当部門の当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、8千9百万円(前年同期比4.7%減)となりました。

(2) 電子部品・情報通信機器事業

半導体及び電子デバイス分野では、デジタル家電等の民生機器関連の商材につきましては、新規取扱商品の寄与もあり回復しつつありますが、全体的な需要は低調に推移しており、特に産業機器向け半導体製品等の不振が続いております。コンピュータシステム関連分野は、経済環境の悪化により新規のIT投資は様子見となっている状態が続いているなか、保守関連ビジネスは堅調に推移しているものの、コンピュータ・ネットワーク機器の販売が伸び悩んでおります。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、184億4千5百万円(前年同期比26.0%減)となりました。

(ご参考) 【連結】

(単位:百万円)

	当期第1Q	前期通期				
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	68,915	508,082	154,827	146,398	101,088	105,767
産業用電子機器事業	50,470	413,874	129,904	119,196	78,253	86,520
半導体製造装置	30,437	325,383	112,546	96,156	57,827	58,852
日本	4,932	105,334	32,896	33,369	21,007	18,061
米国	12,430	65,374	18,909	16,010	13,538	16,915
欧州	2,833	30,389	7,900	6,942	5,751	9,794
韓国	2,861	37,546	14,842	11,791	5,700	5,211
台湾	5,917	49,308	25,724	13,160	4,896	5,526
中国	483	11,087	3,788	3,236	3,301	760
東南アジア他	979	26,343	8,484	11,645	3,631	2,582
FPD/PV製造装置	19,943	88,107	17,264	22,915	20,370	27,557
その他	89	384	93	124	55	110
電子部品・情報通信機器事業	18,445	94,207	24,923	27,202	22,835	19,246
営業利益(△損失)	△14,388	14,710	21,430	4,852	△2,001	△9,570
経常利益(△損失)	△14,021	20,555	22,263	6,644	△74	△8,278
四半期(当期)純利益(△損失)	△11,035	7,543	12,853	4,508	△7,686	△2,132

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ293億1千8百万円減少の4,763億6千8百万円となりました。主な内容は、現金及び預金並びに有価証券に含まれる譲渡性預金の増加124億9百万円、受取手形及び売掛金の減少233億6千6百万円、商品及び製品の減少102億1百万円によるものです。

有形固定資産は、前連結会計年度末から73億7千万円減少し、925億3千5百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から7億7千2百万円減少し、99億8千7百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から88億3千3百万円増加し、614億7千7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から286億2千8百万円減少の6,403億6千9百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ204億2千9百万円減少の688億4千2百万円となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金の減少45億1千9百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ7億3千9百万円増加の512億円となりました。

純資産は、四半期純損失110億3千5百万円を計上したことによる減少、前期の期末配当7億1千5百万円の実施による減少の結果、5,203億2千6百万円となり、また自己資本比率は79.5%となりました。

(2) キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ86億8千2百万円増加し、745億6千6百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金1,480億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ124億9百万円増加し、2,225億6千6百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ202億8千8百万円減少の143億7千2百万円となりました。主な要因につきましては、減価償却費49億1千3百万円、売上債権の減少235億3千1百万円、たな卸資産の減少90億8千9百万円、未収消費税等の減少103億1千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、税金等調整前四半期純損失184億6百万円、前受金の減少額86億2千6百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得等による支出13億3千1百万円、定期預金の純増加による支出36億6千5百万円により、前年同期の6億3千5百万円に対し53億7千2百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払7億1千5百万円により、前年同期の100億4千7百万円に対し10億2百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済環境は、欧米は金融危機と実体経済悪化により不況の長期化が懸念されておりますが、アジアは中国を中心に一部持ち直しの動きが見られております。半導体関連市場につきましては、昨年からの世界的な半導体不況により、半導体メーカーの設備投資は依然として低調に推移している状況であります。半導体価格の回復、設備稼働率の上昇など底入れの兆しは見えてきております。このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間において半導体製造装置部門の売上高が前回予想よりも増加する見込みとなりました。また、利益面では当社グループの経営体質の強化を目的として拠点効率化を実施することに伴い、特別損失が発生することとなりました。

以上の状況を踏まえ、平成21年5月14日に公表した連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

平成22年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通期
売上高	1,440億円 (前年同期比52.2%減)	3,180億円 (前年同期比37.4%減)
産業用電子機器事業	1,075億円 (前年同期比56.8%減)	2,410億円 (前年同期比41.8%減)
半導体製造装置	770億円 (前年同期比63.1%減)	1,810億円 (前年同期比44.4%減)
FPD/PV製造装置	305億円 (前年同期比24.1%減)	600億円 (前年同期比31.9%減)
その他	0億円	0億円
電子部品・情報通信機器事業	365億円 (前年同期比30.0%減)	770億円 (前年同期比18.3%減)
営業利益(△損失)	△360億円	△570億円
経常利益(△損失)	△350億円	△550億円
当期(四半期)純利益(△損失)	△260億円	△380億円

(注) この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
 - ① 固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
 - ② 税金費用の計算
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	54,066	51,156
受取手形及び売掛金	96,320	119,687
有価証券	168,500	159,001
商品及び製品	78,214	88,416
仕掛品	30,661	29,306
原材料及び貯蔵品	16,517	16,518
その他	32,116	41,620
貸倒引当金	△28	△20
流動資産合計	476,368	505,687
固定資産		
有形固定資産	92,535	99,906
無形固定資産		
その他	9,987	10,760
無形固定資産合計	9,987	10,760
投資その他の資産		
その他	69,040	60,189
貸倒引当金	△7,562	△7,545
投資その他の資産合計	61,477	52,644
固定資産合計	164,001	163,311
資産合計	640,369	668,998
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	19,873	24,393
その他の引当金	7,547	11,113
その他	41,421	53,765
流動負債合計	68,842	89,272
固定負債		
退職給付引当金	47,716	47,046
その他の引当金	605	639
その他	2,878	2,773
固定負債合計	51,200	50,460
負債合計	120,042	139,732

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,081	78,114
利益剰余金	392,684	404,435
自己株式	△11,082	△11,111
株主資本合計	514,644	526,398
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	787	△842
繰延ヘッジ損益	76	66
為替換算調整勘定	△6,155	△7,235
評価・換算差額等合計	△5,290	△8,011
新株予約権	1,336	1,148
少数株主持分	9,637	9,729
純資産合計	520,326	529,265
負債純資産合計	640,369	668,998

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
売上高	154,827	68,915
売上原価	102,729	57,715
売上総利益	52,098	11,199
販売費及び一般管理費		
研究開発費	14,562	12,166
その他	16,106	13,421
販売費及び一般管理費合計	30,668	25,588
営業利益又は営業損失(△)	21,430	△14,388
営業外収益		
受取利息	403	281
補助金収入	529	380
その他	310	211
営業外収益合計	1,242	873
営業外費用		
為替差損	211	398
その他	197	108
営業外費用合計	409	506
経常利益又は経常損失(△)	22,263	△14,021
特別利益		
固定資産売却益	25	1
その他	1	—
特別利益合計	26	1
特別損失		
固定資産除売却損	35	10
減損損失	—	4,375
特別損失合計	35	4,386
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	22,253	△18,406
法人税等	9,237	△7,418
少数株主利益	163	48
四半期純利益又は四半期純損失(△)	12,853	△11,035

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	22,253	△18,406
減価償却費	5,110	4,913
減損損失	—	4,375
退職給付引当金の増減額(△は減少)	732	657
賞与引当金の増減額(△は減少)	△9,913	△2,566
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△1,069	△1,026
受取利息及び受取配当金	△451	△297
売上債権の増減額(△は増加)	45,665	23,531
たな卸資産の増減額(△は増加)	△550	9,089
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,996	△4,584
未収消費税等の増減額(△は増加)	13,612	10,315
未払消費税等の増減額(△は減少)	△4,012	—
前受金の増減額(△は減少)	764	△8,626
その他	△2,428	△2,251
小計	60,716	15,124
利息及び配当金の受取額	536	356
利息の支払額	△28	△9
法人税等の支払額	△26,563	△1,099
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,660	14,372
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	8,969	△3,665
有形固定資産の取得による支出	△6,300	△1,331
無形固定資産の取得による支出	△376	△93
投資有価証券の取得による支出	△2,783	—
その他	△144	△282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△635	△5,372
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△62	△126
配当金の支払額	△9,841	△715
その他	△144	△159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,047	△1,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	105	685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	24,082	8,682
現金及び現金同等物の期首残高	193,492	65,883
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	67	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	217,642	74,566

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高	130,175	25,062	155,237	(410)	154,827
営業利益	20,765	656	21,422	7	21,430

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

事業区分	主な製品
産業用電子機器	半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、その他
電子部品・情報通信機器	半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

(単位:百万円)

	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高	50,656	18,497	69,154	(238)	68,915
営業利益又は 営業損失(△)	△14,634	238	△14,395	7	△14,388

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

事業区分	主な製品
産業用電子機器	半導体製造装置、FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置及び太陽電池製造装置、その他
電子部品・情報通信機器	半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア

② 所在地別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高	147,308	32,690	179,998	(25,171)	154,827
営業利益	19,034	2,014	21,048	381	21,430

(注) 1 国又は地域別の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する主な国又は地域

米国、欧州、台湾

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

(単位:百万円)

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高	62,794	17,420	80,215	(11,299)	68,915
営業利益又は 営業損失(△)	△16,176	721	△15,454	1,066	△14,388

(注) 1 国又は地域別の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する主な国又は地域

米国、台湾、欧州

③ 海外売上高

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	台湾	韓国	米国	その他	計
海外売上高	31,249	21,187	18,918	24,136	95,491
連結売上高					154,827
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	20.2	13.7	12.2	15.6	61.7

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他に属する主な国

シンガポール、中国、イスラエル

3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

(単位:百万円)

	米国	台湾	韓国	その他	計
海外売上高	12,437	9,587	7,720	8,534	38,279
連結売上高					68,915
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	18.0	13.9	11.2	12.4	55.5

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他に属する主な国

中国、イスラエル、シンガポール

3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕
	生産高	生産高
産業用電子機器	119,960	35,105
半導体製造装置	97,025	26,305
FPD / PV製造装置	22,934	8,800
合計	119,960	35,105

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕		当第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
産業用電子機器	104,803	286,646	50,273	173,157
半導体製造装置	72,787	144,886	48,753	92,096
FPD / PV製造装置	31,922	141,760	1,430	81,061
その他	93	—	89	—
電子部品・情報通信機器	26,080	14,372	21,781	12,815
合計	130,883	301,019	72,054	185,972

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕
	販売高	販売高
産業用電子機器	129,904	50,470
半導体製造装置	112,546	30,437
FPD / PV製造装置	17,264	19,943
その他	93	89
電子部品・情報通信機器	24,923	18,445
合計	154,827	68,915

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。